

## XP-002210990

AN - 1987-040175 [06]

A - [001] 014 02& 032 034 040 055 056 07& 07- 072 074 076 09& 117 122 140  
143 144 146 147 15- 151 155 157 158 163 166 169 170 173 18& 19- 213  
214 226 228 229 231 28& 308 309 476 50& 506 509 546 623 627 654 688  
694 722

AP - JP19850136102 19850624; JP19850136102 19850624; [Based on J61296067 ]

CPY - TOSM

DC - A85 L03 V04 X12

DR - 1666-U 1669-U 5333-U

FS - CPI;EPI

IC - C08K7/06 ; C08L101/00 ; H01B1/22 ; H05K9/00

KS - 0009 0016 0090 0099 0105 0123 0204 0205 0206 0218 0226 0304 0307 0377  
1093 1096 1277 1279 1282 1292 1323 1355 1462 1990 2215 2220 2545 2551  
2555 2737 3161 3179 3181

MC - A08-M09A A12-E05 L03-A02E

- V04-U X12-D01X

PA - (TOSM ) TOSHIBA CHEM CORP

PN - JP61296067 A 19861226 DW198706 003pp

- JP5005264B B 19930121 DW199306 C08L101/00 002pp

PR - JP19850136102 19850624

XA - C1987-016978

XIC - C08K-007/06 ; C08L-101/00 ; H01B-001/22 ; H05K-009/00

XP - N1987-030549

AB - J61296067 Electroconductive resin compsn. comprises a synthetic resin and 1-10 wt.% of SUS 304 s/s as an electroconductive filler.

- Compsn. of SUS 304 s/s fibre is C (below 0.08%), Si (below 1.00%), Mn (below 2.00%), P (below 0.045%) S (below 0.030%), Ni (8.00-10.50%), Cr (18.00-20.00) and Fe (balance). Synthetic resin is PS, ABS, PC, polybutadiene, modified PPO, PBT, unsatd. polyester, phenol, epoxy resin, etc. used singly or as a blend.

- USE/ADVANTAGE - For electro-conductive moulding material for electromagnetic wave shielding for electronic components. In spite of less filling amt. the prod. has good electro-conductivity (low volume resistivity). Compsn. is inexpensive.(0/0)

AW - CARBON SILICON

AKW - CARBON SILICON

IW - ELECTROCONDUCTING RESIN COMPOSITION COMPRISE SYNTHETIC RESIN POLYBUTADIENE ELECTROCONDUCTING FILL CONTAIN CARBON SILICON MANGANESE IRON

IKW - ELECTROCONDUCTING RESIN COMPOSITION COMPRISE SYNTHETIC RESIN POLYBUTADIENE ELECTROCONDUCTING FILL CONTAIN CARBON SILICON MANGANESE IRON

NC - 001

OPD - 1985-06-24

ORD - 1986-12-26

PAW - (TOSM ) TOSHIBA CHEM CORP

TI - Electroconductive resin compsn. - comprises synthetic resin, e.g. polybutadiene and electroconductive filler contg. e.g. carbon, silicon, manganese and iron

④日本国特許庁 (JP)

④特許出願公開

④公開特許公報 (A) 昭61-296067

④Int.Cl.

C 08 L 101/00  
C 08 K 7/06  
H 01 B 1/22

識別記号

C A H

序内整理番号

6845-4J  
8222-5E

④公開 昭和61年(1986)12月26日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

④発明の名称 導電性樹脂組成物

④特 願 昭60-136102

④出 願 昭60(1985)6月24日

④発明者 岩瀬 英裕 川口市領家5丁目14番25号 東芝ケミカル株式会社川口工場内

④出願人 東芝ケミカル株式会社 東京都港区新橋3丁目3番9号

④代理人 弁理士 諸田 英二

明細書

1. 発明の名称

導電性樹脂組成物

2. 特許請求の範囲

- 合成樹脂に、導電性充填材としてSUS304ステンレス樹脂を1~10重量%含有することを特徴とする導電性樹脂組成物。
- SUS304ステンレス樹脂の化学成分が、炭素0.08%以下、窒素1.00%以下、マンガン2.00%以下、リン0.045%以下、鈰黄0.030%以下、ニッケル0.00~10.50%、クロム18.00~20.00%、残部が鉄である特許第1項記載の導電性樹脂組成物。

3. 発明の詳細な説明

【発明の技術分野】

本発明は、SUS304ステンレス樹脂を含有した導電性の優れた導電性樹脂組成物に関する。

【発明の技術的背景とその問題点】

従来、合成樹脂に導電性充填材を配合混練して導電性の樹脂を得る場合には、炭素の粉末、炭素粉

粉、金属粉末、金属樹脂を1種又は2種以上用いて導電性を得ていた。しかし、体積抵抗率で10<sup>11</sup>Ω・cm以下という高い導電性を得るためにには、炭素の粉末、炭素樹脂では不十分であり、また金属粉末を混練する場合は、樹脂に対して60重量%以上充填しないと高い導電性が得られないという欠点がある。更に金属樹脂でも粒径が太い銀樹脂や銅銀樹脂は30重量%以上の充填が必要であり、そのため比重が大きくなる欠点がある。また、粒径の細いSUS316ステンレス樹脂を充填すると、樹脂の粘度が上昇したり、樹脂組成物製造時の機械的混練によって樹脂が切断され所定の導電性を得られないため、15重量%以上充填しなければならないという欠点があった。

【発明の目的】

本発明の目的は、上記従来の欠点を解消するためになされたもので、充填量が少なくて、優れた導電性を有し、かつ比重が小さく、低コストの導電性樹脂組成物を提供しようとするものである。

【発明の要旨】

本発明者は、上記の目的を達成し上うと検査結果を重ねた結果、所定量のSUS304ステンレス樹脂を充填材として使用すれば、優れた導電性を有し、低比価で、かつ低コストの樹脂組成物が得られることを見いだし、本発明を完成するに至ったものである。

すなわち本発明は、合成樹脂に、導電性充填材としてSUS304ステンレス樹脂を1~10重量%含有することを特徴とする導電性樹脂組成物である。そしてSUS304ステンレス樹脂の化学成分が、炭素0.08%以下、硅素1.00%以下、マンガン2.00%以下、リン0.045%以下、硫黄0.030%以下、ニッケル8.00~10.50%、クロム18.00~20.00%、残部が鉄というもので、通常のSUS316ステンレスよりクロムの含有量が多く、ニッケルの含有量が少なく、かつモリブデンを全く含まないものである。従ってこの樹脂はSUS316の樹脂にくらべて若干硬く、樹脂の折れや切断が少ないという性質がある。また、SUS316は非磁性であるがこの樹脂は弱磁性である。SUS304ステンレス樹脂の充填割合は、樹脂組成物に対して1~10重量%であることが好ましい。充填量が1重量%未満の場合は、導電性に効果がなく、10重量%を超えると比価が大きくなる。

本発明に用いる合成樹脂としては、ポリスチレン樹脂、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリブタジエン樹脂、液体PPO樹脂、ポリブチレンテレフタレート樹脂、不飽和ポリエステル樹脂、フェノール樹脂、エポキシ樹脂等が挙げられ、これらは単独もしくは2種以上混合して使用する。

- 3 -

またコスト高となり好ましくない。従って前記の範囲内に限定される。

合成樹脂とSUS304ステンレス樹脂を用いて導電性樹脂組成物を製造する方法は、通常行わるよう、合成樹脂とステンレス樹脂を加熱混練して製造する。本発明の導電性樹脂組成物は、必要に応じてまた本発明に係る効果を損わない限りでその他の添加剤を加えることができる。こうして得られる導電性樹脂組成物は電子機器等の電磁波シールド成形品として使用される。

#### 【発明の実施例】

次に本発明を実施例によって説明するが、本発明はこの実施例によって限定されるものではない。

#### 実施例 1~2

第1表に示した組成によって、粒径8μmのSUS304ステンレス樹脂6000本束ねたものをポリエチレンテレフタレートで収束し、長さ5mmにカットして、ポリスチレン樹脂と加熱混練して導電性樹脂組成物を製造した。これを用いて射出成形して皮形品を得、その体積抵抗率およ

- 5 -

本発明に用いる導電性充填材としてのステンレス樹脂は、SUS304と呼ばれる材質で、粒径が6~15μmで1000~15000本束ねたものである。粒径が6μm未満であると樹脂の粘度が上昇し、また15μmを超えるとコスト高となり好ましくない。SUS304ステンレス樹脂の化学成分は、炭素0.08%以下、硅素1.00%以下、マンガン2.00%以下、リン0.045%以下、硫黄0.030%以下、ニッケル8.00~10.50%、クロム18.00~20.00%、残部が鉄というもので、通常のSUS316ステンレスよりクロムの含有量が多く、ニッケルの含有量が少なく、かつモリブデンを全く含まないものである。従ってこの樹脂はSUS316の樹脂にくらべて若干硬く、樹脂の折れや切断が少ないという性質がある。また、SUS316は非磁性であるがこの樹脂は弱磁性である。SUS304ステンレス樹脂の充填割合は、樹脂組成物に対して1~10重量%であることが好ましい。充填量が1重量%未満の場合は、導電性に効果がなく、10重量%を超えると比価が大きくなる。

- 4 -

び比価を試験したのでその結果を第1表に示した。本発明の導電性樹脂組成物は体積抵抗率が小さく、かつ比価も小さく本発明の効果が認められた。

#### 比較例

第1表に示した組成によって、粒径8μmのSUS316ステンレス樹脂6000本束ねたものをポリエチレンテレフタレートで収束し、長さ5mmにカットして実施例1~2と同様にして導電性樹脂組成物を製造した。次いで実施例1~2と同様にして導電性樹脂組成物を用いて射出成形によって成形品を得、実施例と同様にして試験を行った。その結果を第1表に示した。

- 6 -

第 1 表

(単位)

項目	実施例		比較例
	1	2	
組成(重量部)			
ポリスチレン樹脂	90	97	85
導電性充填材:1			
SUS304ステンレス繊維	10	3	—
SUS316ステンレス繊維	—	—	15
物理			
体積抵抗率 ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	$7.6 \times 10^{-3}$	$9.1 \times 10^{-2}$	$6.0 \times 10^{-2}$
比重	1.15	1.08	1.21

注1: 構成 8.5mm、長さ5mm の供給

## 【発明の効果】

本発明の導電性樹脂組成物は、所定量のSUS304ステンレス繊維を充填することによって、少ない充填量にもかかわらず優れた導電性を有し、比重の小さい、低コストの成形品を得ることができる。ステンレス繊維の充填量が少ないため樹脂の粘度上昇や比重の増大がなくなり、また機械的混練による樹脂の切削もなくなり優れた導電性を示した。

- 7 -